

宁波康强电子股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书



保荐机构（主承销商）



上海市静安区新闻路 1508 号

二〇一三年三月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

郑康定

郑 芳

曹光伟

冯小龙

毕克允

沈成德

贺正生

宁波康强电子股份有限公司

2013年2月27日

特别提示

1、本次非公开发行 A 股新增股份 1,200 万股，发行价格为 7.73 元/股，募集资金总额为人民币 9,276.00 万元，募集资金净额为人民币 8,604.00 万元。

2、本次发行中，任伟达和郑康定分别认购 630 万股和 570 万股，任伟达和郑康定认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票结束之日起 36 个月，预计上市流通时间为 2016 年 3 月 5 日(非交易日顺延)。

3、本次非公开发行股票完成后，宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“宁波普利赛思”）和宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）和郑康定分别占本次发行后总股本的 19.721%、8.520%和 2.764%，合计持有康强电子 31.01%股权，触发了要约收购康强电子股份的义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条相关规定，由于本次发行前后，康强电子的实际控制人和控股股东没有发生改变，郑康定及宁波普利赛思、宁波司麦司可以免于向中国证监会提交豁免申请。公司于 2013 年 2 月 7 日召开董事会，审议郑康定及其一致行动人豁免要约收购事宜，并于 2013 年 2 月 25 日召开股东大会，由非关联股东审议通过上述事项。发行人律师已就郑康定及其一致行动人豁免要约收购行为发表了专项核查意见，发行人于 2013 年 2 月 26 日就上述事项进行了公告。本次发行的股份将按照证券登记结算机构的规定办理股权登记事宜。

4、上述股份将于 2013 年 3 月 5 日起在深圳证券交易所上市，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2013 年 3 月 5 日（上市日）不除权。

5、本次非公开发行完成后，公司股权分布仍具备《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

6、根据 2011 年 12 月 16 日经发行人 2011 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，本次发行对象分别为宁波汇峰投资控股股份有限公司（以下简称“汇峰投资”）、任颂柳、任伟达及郑康定，四家认购对象与公司已于 2011 年 11 月 28 日分别签署了《关于宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

鉴于汇峰投资与任颂柳未按照《认购协议》约定参与本次非公开发行，已构成违约，根据《认购协议》“第九条 违约责任”中 9.1 的约定，汇峰投资及任颂柳应负责赔偿发行人因此而受到的损失。公司拟于本次非公开发行股份事宜结束后，预计于 3 月份启动对违约方的违约责任的追究工作，公司董事会将形成预案提交股东大会审议。违约责任追究的方式有以下两种：1、协商。与违约方进行协商，寻求快速解决纠纷的可能性。2、诉讼。在协商无果的情况下，采取向法院起诉的方式，通过司法途径解决纠纷。公司届时将视情况灵活选择具体方式。

目 录

释 义.....	5
第一节 本次发行的基本情况	6
一、本次发行履行的相关程序.....	6
(一) 本次发行履行的内部决策过程.....	6
(二) 本次发行监管部门的审核过程.....	6
(三) 募集资金到账和验资情况.....	6
(四) 股份登记托管情况.....	7
二、本次发行的基本情况.....	7
(一) 发行股票的种类、面值及数量.....	7
(二) 发行价格.....	7
(三) 募集资金和发行费用.....	8
三、发行对象情况介绍.....	8
(一) 自然人任伟达先生情况介绍.....	8
(二) 自然人郑康定先生情况介绍.....	8
四、本次发行的相关机构.....	11
第二节 本次发行前后公司基本情况	13
一、本次发行前后公司前 10 名股东持股情况	13
(一) 本次发行前公司前 10 名股东持股情况	13
(二) 本次发行后公司前 10 名股东持股情况	13
(三) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	14
二、本次发行对公司的影响.....	14
(一) 对公司股本结构的影响.....	14
(二) 对公司资产结构影响.....	15
(三) 本次发行前后公司每股净资产、每股收益对比情况.....	16
(四) 对公司业务结构影响.....	16
(五) 对公司治理的影响.....	16
(六) 对高管人员结构的影响.....	16
(七) 对同业竞争和关联交易的影响.....	17
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析	18

一、最近三年一期主要财务数据与财务指标.....	18
(一) 资产负债表主要数据.....	18
(二) 利润表主要数据.....	18
(三) 现金流量表主要数据.....	18
(四) 财务指标.....	19
二、管理层讨论与分析.....	19
(一) 资产状况分析.....	19
(二) 负债状况分析.....	20
(三) 偿债能力分析.....	20
(四) 营运能力分析.....	22
(五) 盈利能力分析.....	22
(六) 现金流量分析.....	24
第四节 本次募集资金使用计划	28
一、本次募集资金使用计划.....	28
二、本次募集资金投资项目基本情况.....	28
(一) 年产 3000 万条高密度集成电路框架 (QFN) 生产线项目.....	28
(二) 年产 50 亿只平面阵列式 LED 框架生产线 (一期) 项目.....	30
三、本次募集资金的专户制度.....	31
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	32
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	32
第六节 新增股份数量及上市时间	33
第七节 保荐协议主要内容及上市推荐意见	34
一、保荐协议主要内容.....	34
二、上市推荐意见.....	34
第八节 有关中介机构声明	35
第九节 备查文件	38
一、备查文件.....	38
二、查阅地点.....	38

释 义

在本报告中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

发行人、康强电子、公司	指	宁波康强电子股份有限公司
公司章程	指	宁波康强电子股份有限公司公司章程
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	宁波康强电子股份有限公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行A股股票
集成电路	指	由两个以至众多的半导体晶体管构成的一个电子元件，少则只有几个，多则上万个。集成电路是一种采用特殊工艺，将晶体管、电阻、电容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件
引线框架	指	引线框架作为半导体的芯片载体，是一种借助于键合丝实现芯片内部电路引出端与外部电路（PCB）的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体中都需要使用引线框架，是电子信息产业中重要的基础材料；产品类型有TO、DIP、SIP、SOP、SSOP、QFP、QFN、SOD、SOT等；主要用模具冲压法和蚀刻法进行生产
QFN	指	Quad Flat Non-leaded Package的缩写，四侧无引脚扁平封装
LED	指	Light Emitting Diode的缩写，发光二极管
A 股	指	每股面值1.00元人民币之普通股
元	指	人民币元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
光大证券、保荐机构、主承销商	指	光大证券股份有限公司
发行人律师、律师、律师事务所、康达律师事务所	指	北京市康达律师事务所
会计师、会计师事务所、审计机构、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），曾名天健会计师事务所有限公司

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

发行人本次非公开发行股票方案经公司于2011年5月18日召开的第三届董事会第十八次会议和2011年6月8日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过。

经2011年11月29日召开的第四届董事会第四次会议和2011年12月16日召开的发行人2011年度第三次临时股东大会，公司审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案，对本次非公开发行的发行对象及认购方式、定价依据、定价基准日与发行价格、发行股份的限售期以及发行决议的有效期等进行了调整。

（二）本次发行监管部门的审核过程

本次非公开发行股票的申请于2012年6月18日经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2012年8月13日，中国证监会核发《关于核准宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1103号），核准公司非公开发行不超过5,700万股新股。

（三）募集资金到账和验资情况

1、发行人及光大证券已于2013年1月7日向本次非公开发行的发行对象发出了《宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，要求全体发行对象根据该《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。

2、2013年2月4日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字[2013]第0093号《验资报告》，审验确认：截至2013年2月4日15:00时止，光大证券在中国银行上海市分行开立的450759214149账户内，收到康强电子非公开发行普通股（A股）发行对象缴纳的认股款人民币92,760,000元。其中，任伟达的认购数量

6,300,000.00股，缴款金额人民币48,699,000.00元；郑康定认购数量5,700,000.00股，缴款金额人民币44,061,000.00元。

3、2013年2月6日，天健会计师事务所出具了天健验[2013]24号《验资报告》：审验确认，截至2013年2月5日止，康强电子实际已向郑康定和任伟达发行人民币普通股（A股）股票1,200万股，募集资金总额为92,760,000.00元，减除发行费用6,720,000.00元后，募集资金净额为86,040,000.00元。其中，计入实收资本人民币12,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）74,040,000.00元。截至2013年2月5日止，变更后的注册资本为人民币206,200,000.00元，累计实收资本人民币206,200,000.00元。

（四）股份登记托管情况

本次发行的A股已于2013年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记托管及股份限售手续。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类、面值及数量

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。本次非公开发行股票最终发行数量为1,200万股，鉴于汇峰投资和任颂柳未按照《关于宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》约定参与本次非公开发行的股份认购，本次非公开发行的最终发行对象为任伟达和郑康定共2名自然人投资者。其中，任伟达认购股份数量为630万股，郑康定认购股份数量为570万股。

（二）发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票第四次董事会第四次会议决议公告日（即2011年11月29日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即7.73元/股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

（三）募集资金和发行费用

本次募集资金总额为9,276.00万元，扣除发行费用672.00万元（包括承销保荐费、审计及验资费、律师费等）后的募集资金净额为8,604.00万元，未超过本次募集资金投资项目拟使用的募集资金投资额59,950.00万元。

三、发行对象情况介绍

（一）自然人任伟达先生情况介绍

1、基本情况

任伟达，男，1980年12月出生，现任宁波市鄞州赛乐进出口贸易有限公司经理，住所为浙江省宁波市江东区甬港北路48弄38号304室，居民身份证号码（后四位隐去）为33022719801218****。最近五年主要任职情况如下：

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2002-2005年	宁波市鄞州区烟草公司	财务	否
2006-2009年	宁波晶盛物资有限公司	财务	否
2008年-至今	宁波市鄞州赛乐进出口贸易有限公司	经理	是。持有该公司50%股份

2、认购数量：630万股；

3、限售期：自本次发行结束之日起36个月，自2013年3月5日至2016年3月4日；

4、与发行人的关联关系：与发行人无关联关系；

5、任伟达及其关联方最近一年与发行人之间不存在其他重大交易，未来6个月内暂无相关的交易安排。

（二）自然人郑康定先生情况介绍

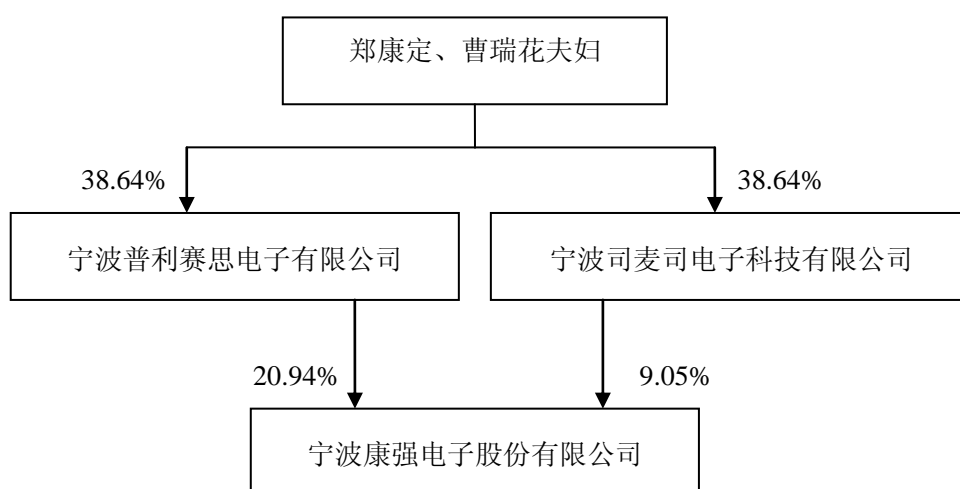
1、基本情况

郑康定，男，1948年9月出生，中国国籍，住址为浙江省宁波市江东区华

绣巷 75 号 101 室，居民身份证号码（后四位隐去）为 33022719480906****。高级经济师，曾任宁波沪东无线电厂、宁波沪东无线电有限公司、宁波普利赛思电子有限公司厂长、董事长，1992 年至 2002 年 10 月任宁波康强电子有限公司董事、总经理，2002 年 1 月起任宁波康强电子有限公司董事长，2002 年 10 月至 2008 年 10 月任公司总经理，2002 年 10 月至今任公司董事长，2011 年 9 月起至今任公司总经理，具有半导体封装材料行业 20 多年的任职经历和管理经验。

2、与本公司的股权控制关系

本次发行前，除直接持有公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“宁波普利赛思”）34.04%股份和第二大股东宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）34.04%股份外，郑康定无其他股权投资。郑康定夫妇是公司的实际控制人，合计持有宁波普利赛思 38.64%股份，合计持有宁波司麦司 38.64%股份。本次发行前，郑康定夫妇与本公司的股权控制关系如下图所示：



郑康定夫妇控制的宁波普利赛思和宁波司麦司的基本情况如下：

公司名称	注册地	组织机构代码	经营范围	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)
宁波普利赛思	宁波	14445558-1	电子元器件及配件、模具的制造、加工	股东	164 万元	20.94
宁波司麦司	宁波	144126403	电子产品的研发，灯具的制造；家用电器、电	股东	1000 万元	9.05

			子产品及元件、电工器材、通信器材、、办公自动化设备、电子玩具、机电设备、仪器仪表的批发、零售。			
--	--	--	---	--	--	--

3、认购数量：570万股；

4、限售期：自本次发行结束之日起36个月，自2013年3月5日至2016年3月4日；

5、与发行人的关联关系：是发行人的董事长，郑康定夫妇是发行人的实际控制人；

6、该发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排：

(1) 郑康定本人与发行人最近一年无其他重大交易，未来6个月内暂无相关的交易安排。

(2) 2011年，公司向郑康定夫妇控制的宁波普利赛思采购所需的产品包装用辅助材料线圈共计169.38万元，占同类业务交易金额的比例为0.94%，属于公司日常生产经营中的零星采购，公司已与宁波普利赛思签署了《产品购销合同》。

对于上述经常性关联交易的未来交易安排：本次发行完成后，公司与宁波普利赛思将继续存在上述交易。对于未来发生的关联交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并会及时履行信息披露义务。

(3) 2011年，公司及其子公司向宁波普利赛思租赁其位于宁波鄞州区铜盆浦电镀城二期的相关厂房，共计支付租赁费8.25万元，2011年10月起不再向股东宁波普利赛思租赁厂房。

公司控股子公司康强胜唐与公司股东宁波司麦司已于2012年2月签署了《租赁协议》，租赁其位于宁波市鄞州区启明路818号23幢154号的办公楼（300平方米），租赁期从2012年2月10至2015年2月9日，约定年租金为6万元。

对于上述关联租赁的未来交易安排：本次发行完成后，公司及其子公司不再向宁波普利赛思租赁厂房，但公司的控股子公司向宁波司麦司的租赁交易将继续存在。对于未来发生的关联交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并会及时履行信息披露义务。

(4) 担保方面，公司股东宁波普利赛思存在为康强电子提供担保的情形，康强电子不存在为郑康定及其关联方提供担保的情形。目前仍有效的的关联担保情况如下：

担保方	被担保方	日期	担保金额	担保起止日期
宁波普利赛思	康强电子	2012 年度	2012 年 1-3 月签署了：4,000 万元保证合同	2012-1-4 至 2013-1-3
		2010 年度	2010 年签署了： (1) 22,000 万元担保合同； (2) 8,000 万元担保合同； (3) 6,000 万元担保合同	(1) 2010-2-8 至 2013-2-8； (2) 2010-8-4 至 2013-8-4； (3) 2010-1-19 至 2013-12-31

对于上述关联担保的未来交易安排：本次发行完成后，公司与宁波普利赛思将继续存在上述关联担保。对于未来发生的关联交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并会及时履行信息披露义务。

四、本次发行的相关机构

- (一) 保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司
 法定代表人： 徐浩明
 住 所： 上海市静安区新闻路 1508 号
 电 话： 021-22167133
 传 真： 021-22167124
 保荐代表人： 竺勇、于荟楠
 项目协办人： 王理
 其他项目人员： 聂辛、李伟、岑圣锋、马涛
- (二) 发行人律师事务所： 北京市康达律师事务所
 负 责 人： 付洋
 住 所： 北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦
 2301 号

电 话： 010-58918166
传 真： 010-58918199
签字律师： 鲍卉芳、王萌、苗丁
（三）发行人审计机构： 天健会计师事务所
法定代表人： 胡少先
住 所： 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
电 话： 0571-87178708
传 真： 0571-88216860
签字注册会计师： 施其林、章磊

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后公司前 10 名股东持股情况

(一) 本次发行前公司前 10 名股东持股情况

截至2013年1月31日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东	股份（股）	持股比例（%）	股份性质	限售期截止日
1	宁波普利赛思电子有限公司	40,664,400	20.94	境内一般法人	无
2	宁波司麦司电子科技有限公司	17,568,960	9.05	境内一般法人	无
3	刘俊良	6,705,620	3.45	境外自然人	无
4	钱旭利	3,710,389	1.91	境内自然人	无
5	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,384,673	1.74	境内一般法人	无
6	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,765,019	0.91	境内一般法人	无
7	徐万茂	1,222,716	0.63	境内自然人	无
8	林赛波	974,520	0.50	境内自然人	无
9	於仲明	700,000	0.36	境内自然人	无
10	赵霞	660,000	0.34	境内自然人	无
	前十名股东合计持股数	77,356,297	39.83		
	其他股东	116,843,703	60.17		
	合计	194,200,000	100.00		

(二) 本次发行后公司前 10 名股东持股情况

本次非公开发行新股完成股份登记后，截至2013年2月27日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东	股份（股）	持股比例	股份性质	限售期截止日
1	宁波普利赛思电子有限公司	40,664,400	19.72%	境内一般法人	无
2	宁波司麦司电子科技	17,568,960	8.52%	境内一般法	无

	有限公司			人	
3	刘俊良	6,705,620	3.25%	境外自然人	无
4	任伟达	6,300,000	3.06%	境内自然人	自发行结束之日起 36 个月
5	郑康定	5,700,000	2.76%	境内自然人	自发行结束之日起 36 个月
6	钱旭利	3,710,389	1.80%	境内自然人	无
7	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,318,773	1.61%	境内一般法人	无
8	徐万茂	1,222,716	0.59%	境内自然人	无
9	林赛波	974,520	0.47%	境内自然人	无
10	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	920,900	0.45%	境内一般法人	无
	前十名股东合计持股数	87,086,278	42.23%	-	-
	其他股东	119,113,722	57.77%	-	-
	合计	206,200,000	100.00%	-	-

(三) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

在本次非公开发行中，公司董事长郑康定先生认购非公司发行股票570万股，其所直接持有公司股票由0股变更为570万股；除此之外，在本次发行后，公司其他董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量均未发生变化。

二、本次发行对公司的影响

(一) 对公司股本结构的影响

本次非公开发行后公司将增加 1,200 万股限售流通股，发行前后股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	持股总数 (股)	持股比 例	新增股数 (股)	持股总数 (股)	持股比 例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	12,000,000	12,000,000	5.82%

1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股			12,000,000	12,000,000	5.82%
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股			12,000,000	12,000,000	5.82%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份					
二、无限售条件股份	194,200,000	100.00%		194,200,000	94.18%
1、人民币普通股					
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	194,200,000	100.00%	12,000,000	206,200,000	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行股票完成后，宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“宁波普利赛思”）和宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）和郑康定分别占本次发行后总股本的 19.721%、8.520%和 2.764%，合计持有康强电子 31.01%股权，触发了要约收购康强电子股份的义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条相关规定，由于本次发行前后，康强电子的实际控制人和控股股东没有发生改变，郑康定及宁波普利赛思、宁波司麦司可以免于向中国证监会提交豁免申请。公司于 2013 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议，审议郑康定及其一致行动人豁免要约收购事宜，并于 2013 年 2 月 25 日召开 2013 年第一次临时股东大会，由非关联股东审议通过上述事项。律师已就郑康定及其一致行动人豁免要约收购行为发表了专项核查意见，发行人于 2013 年 2 月 26 日就上述事项进行了公告。

（二）对公司资产结构影响

本次发行后，公司净资产将有所增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力也将有所改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合

理，增强公司发展后劲。

（三）本次发行前后公司每股净资产、每股收益对比情况

以公司截至 2011 年 12 月 31 日及 2012 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2011 年和 2012 年三年度归属于母公司所有者的净利润为基准，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产（元/股）	2012 年 9 月 30 日	3.21	3.44
	2011 年 12 月 31 日	3.19	3.42
每股收益（元/股）	2012 年 1-9 月	0.08	0.08
	2011 年度	0.06	0.05

（四）对公司业务结构影响

目前，公司的主营业务为引线框架、键合金丝等半导体或微电子封装专用材料的制造和销售。本次非公开发行募集资金项目实施完成后，公司主营业务不变，主营产品引线框架品种更加丰富，公司的经营能力和市场竞争力将得到进一步提升。

（五）对公司治理的影响

本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次股票发行完成后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

（六）对高管人员结构的影响

本次股票发行后，公司的董事、监事和高管人员保持相对稳定，上述人员没有因此次发行而发生重大变化。

（七）对同业竞争和关联交易的影响

除郑康定为本公司董事长外，公司与本次发行的另一发行对象任伟达之间不存在关联关系，本次发行不会产生新的关联交易和同业竞争情况。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、最近三年一期主要财务数据与财务指标

公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度财务报告均由天健会计师事务所，并分别出具了天健审[2010]1788 号、天健审[2011]1566 号和天健审[2012]518 号标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度经审计的及 2012 年 1-9 月未经审计的合并财务报表，近三年一期，公司主要财务数据及财务指标如下：

(一) 资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
资产总额	163,805.00	166,480.81	142,250.83	108,767.67
负债总额	97,574.05	101,592.46	73,235.12	45,822.73
股东权益	66,230.95	64,888.35	69,015.71	62,944.94
少数股东权益	3,980.68	2,988.67	3,290.78	3,560.50

(二) 利润表主要数据

单位：万元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	95,634.40	150,271.71	103,972.93	63,352.22
营业成本	85,125.05	135,894.04	88,234.29	54,026.58
营业利润	624.47	-11.64	6,361.52	4,116.66
利润总额	1,725.95	691.26	8,021.77	4,753.50
净利润	1,599.99	822.21	6,844.45	4,737.81

(三) 现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金	-3,742.65	9,462.91	-8,058.71	3,254.06

流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	905.45	-11,081.45	-4,644.40	-7,007.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,737.01	9,106.85	9,256.07	-40.48

(四) 财务指标

项目	2012年 9月30日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
流动比率	1.10	1.14	1.34	1.36
速动比率	0.78	0.84	0.85	0.96
资产负债率(母公司报表)(%)	52.65	54.08	45.69	40.94
资产负债率(合并报表)(%)	59.57	61.02	51.48	42.13
应收账款周转率(次)	2.77	5.29	4.38	3.26
存货周转率(次)	3.06	4.95	3.88	3.92
每股净资产(元)	3.21	3.19	3.38	3.06
每股经营活动现金流量(元)	-0.19	0.49	-0.41	0.17
每股净现金流量(元)	-0.34	0.39	-0.18	-0.20
扣除非经常性损益前每股收益(元)	基 本	0.08	0.06	0.35
	稀 释	0.08	0.06	0.35
扣除非经常性损益前净资产收益率(%)	全面摊薄	2.62	1.81	10.49
	加权平均	2.60	1.71	10.97
扣除非经常性损益后每股收益(元)	基 本	-0.03	-0.08	0.21
	稀 释	-0.03	-0.08	0.21
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	全面摊薄	-0.96	-2.58	6.26
	加权平均	-0.95	-2.43	6.55

二、管理层讨论与分析

(一) 资产状况分析

报告期各期末，公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下：

项目	2012.9.30		2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动资产	98,316.17	60.02%	100,600.88	60.43	78,028.31	54.85	58,362.61	53.66

非流动资产	65,488.83	39.98%	65,879.93	39.57	64,222.51	45.15	50,405.06	46.34
资产总额	163,805.00	100.00%	166,480.81	100.00	142,250.83	100.00	108,767.67	100.00

报告期内，公司流动资产比例逐渐提高，短期偿债能力增强。随着公司业务规模的逐步扩大，公司资产总额不断扩大。

（二）负债状况分析

报告期内公司流动负债、非流动负债及其占负债总额比例情况如下：

项目	2012.9.30		2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动负债	89,451.23	91.68	88,025.14	86.65	58,300.13	79.61	42,969.73	93.77
非流动负债	8,122.82	8.32	13,567.32	13.35	14,934.99	20.39	2,853.00	6.23
负债总额	97,574.05	100.00	101,592.46	100.00	73,235.12	100.00	45,822.73	100.00

公司负债结构以流动负债为主，流动负债主要为银行借款和应付款项。

发行人最近三年及一期合并口径的公司银行借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
短期借款	51,390.00	51,898.72	30,450.00	26,400.00
长期借款	4,100.00	9,200.00	10,000.00	-
合计	55,490.00	61,098.72	40,450.00	26,400.00
占负债总额比例 (%)	56.87	60.14	55.23	57.61

发行人银行借款以短期借款为主，2011年末，发行人短期借款占借款总额的比例为84.94%。近年来，随着发行人业务规模扩大及加大生产投资，公司贷款规模从2009年底的28,400.00万元增至2011年末的61,098.72万元。发行人需要通过多种融资渠道满足生产、研发不断发展的需要。发行人资信情况良好，不存在逾期未偿还银行借款情况。

（三）偿债能力分析

发行人最近三年及一期的主要偿债能力指标如下：

项目	2012年 9月30日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
货币资金(万元)	11,327.15	18,195.89	8,278.39	11,398.71
资产负债率(母公司,%)	52.65	54.08	45.69	40.94
资产负债率(合并,%)	59.57	61.02	51.48	42.13
流动比率	1.10	1.14	1.34	1.36
速动比率	0.78	0.84	0.85	0.96
利息保障倍数(倍)	3.14	1.15	3.83	3.57
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-3,742.65	9,462.91	-8,058.71	3,254.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	0.49	-0.41	0.17

发行人自首次公开发行以来未进行股权融资，随着投资的增加和经营规模的扩大，发行人资产负债率逐年上升，但资产负债结构仍处于合理水平。发行人流动比率和速动比率正常，保持了良好的流动性。

2011年以来，受银行贷款利率、票据贴现利率提高的影响，发行人财务费用大幅上升，导致利息保障倍数有所下降。

2010年度发行人经营活动产生的现金流量净额出现负数，主要是由于2010年度发行人产能、生产规模的扩大以及原材料铜、黄金、白银价格大幅度上涨，导致公司存货相应增加，增加了对经营性现金的占用；同时，随着公司业务规模的扩大，销售金额大幅度增加，公司年末应收账款和未到期应收票据余额上升，也增加了对经营性现金的占用。2011年度，公司在原材料采购中采用黄金租赁方式和国内信用证支付方式，加上有效加强存货和应收账款的内部管理和控制，公司经营活动产生的现金流量净额相对于2010年度有明显好转和改善。

公司具有良好的商业信誉，同时，公司获得一定的银行授信额度，资产负债结构合理，并未有逾期贷款，具有较好的偿债能力。

(四) 营运能力分析

发行人最近三年及一期的资产运营能力指标如下：

项目	2012年 9月30日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
资产周转率（次）	0.58	0.97	0.83	0.62
应收帐款周转率 （次）	2.77	5.29	4.38	3.26
存货周转率（次）	3.06	4.95	3.88	3.92

2010年、2011年发行人资产周转率、应收账款周转率、存货周转率呈上升趋势，在销售规模扩大，催收力度加强的情况下，公司提高了资产运营能力。

发行人的主要客户大多为半导体行业内信誉较好的公司，大部分与发行人有较长时间的合作，还款记录良好。最近三年及一期，发行人通过积极拓展销售渠道，提高市场占有率，在主营业务收入大幅增长同时，提高资产运营能力。

(五) 盈利能力分析

发行人最近三年及一期的主要盈利能力指标如下：

项目	2012年 1-9月	2011年	2010年	2009年
归属于上市公司母公司所有者的净利润（万元）	1,627.98	1,124.32	6,893.04	4,721.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-597.15	-1,596.81	4,113.90	2,614.46
毛利率（%）	10.99	9.57	15.14	14.72
总资产收益率（%）	0.99	0.53	5.45	4.64
加权平均净资产收益率（%）	2.6	1.71	10.97	8.73
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.95	-2.43	6.55	4.83
基本每股收益（元）	0.08	0.06	0.35	0.24

稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.35	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	0.21	0.13

2008 年金融危机对半导体行业产生较大影响，2009 年下半年起半导体行业开始复苏，发行人抓住半导体行业复苏的机遇，积极扩大产能，大力拓展国内外市场，公司业绩获得较大提升。2009 年至 2010 年，公司综合毛利率持续上升。2011 年受原辅材料价格剧烈波动、公司贷款规模扩大、利率不断提高等因素的影响，发行人盈利能力及毛利水平有所下滑。

报告期，发行人盈利情况如下表：

项目	2012 年 1-9 月	2011 年	2010 年	2009 年
1、营业收入	95,634.40	150,271.71	103,972.93	63,352.22
2、营业总成本	96,324.90	152,427.11	99,222.36	60,822.82
3、公允价值变动收益	533.86	-177.57	-87.06	64.21
4、投资收益	781.10	2,321.34	1,698.01	1,523.05
5、营业利润	624.47	-11.64	6,361.52	4,116.66

其中，营业毛利情况如下：

项目	2012 年 1-3 月	2011 年	2010 年	2009 年
营业收入	95,634.40	150,271.71	103,972.93	63,352.22
营业成本	85,125.05	135,894.04	88,234.29	54,026.58
营业毛利小计	10,509.35	14,377.67	15,738.64	9,325.64

公司 2010 年和 2011 年营业总收入分别为 103,972.93 万元和 150,271.71 万元，营业利润 2010 年和 2011 年分别为 6,361.52 万元和-11.64 万元。公司 2011 年营业利润亏损的主要原因如下：

(1) 由于白银价格波动未纳入引线框架产品定价的联动机制，导致因白银价格大幅上涨而影响公司产品毛利

公司的主要产品为引线框架和键合金丝，其中，用于生产引线框架的主要原材料为铜带及银盐（主要成份为白银），用于生产键合金丝的主要原材料为黄金。在销售定价上，公司与下游客户建立了引线框架产品售价与市场铜价联动、键合

金丝产品与市场黄金价格联动的定价机制。但由于历史上白银价格比较平稳，在引线框架产品的销售定价方面，公司与下游客户没有建立产品价格与白银市价的联动机制。而白银价格自 2010 年 9 月以来大幅上涨，2010 年初为 4,100 元/千克，2011 年 4 月国内银价最高涨至 10,300 元/公斤。白银价格的上涨导致 2011 年公司引线框架的生产成本大幅上升，银价上涨对公司 2011 年成本增加的影响合计为 5,081.37 万元。

(2) 财务费用大幅增加

由于扩大投资和销售规模，公司借款金额 2011 年末与 2010 年末相比增加 2.06 亿元，2010 年以来，在国家收紧银根、利率上调等宏观背景下，公司利息支出大幅增加，导致公司财务费用大幅上升。公司财务费用 2011 年比 2010 年增加 2,365.06 万元。

(3) 公司加大研发投入力度

公司一贯重视新产品开发和技术储备，2011 年公司继续加大研发及投资力度，为新产品开发作好技术储备。公司 2011 年研发费用投入比 2010 年增加 792.02 万元。

(4) 劳动力成本增加

报告期内，公司用工成本不断上升，仅 2011 年公司人力资源成本支出与 2010 年相比约增加 1,480 万元。

上述主要因素对公司 2011 年利润影响金额约为 9,700 万元，使公司 2011 年营业利润出现亏损。公司一方面积极拓展销售渠道，并通过改进工艺、提高原材料利用率等措施强化控制生产成本，以提高公司产品的毛利率水平，同时不断研发新产品，提升产品档次，改善和调整产品结构；另一方面通过严格控制费用支出、拓宽融资渠道，减少期间费用等方式，增强公司的盈利能力。

(六) 现金流量分析

发行人近三年一期现金流量主要项目基本情况如下：

单位：万元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年	2010 年	2009 年
----	--------------	--------	--------	--------

销售商品、提供劳务收到的现金流量	95,567.60	151,755.20	83,834.87	59,221.53
购买商品、接受劳务支付的现金流量	91,960.69	126,889.00	85,151.63	51,826.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,742.65	9,462.91	-8,058.71	3,254.06
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.19	0.49	-0.41	0.17
投资活动产生的现金流量净额	905.45	-11,081.45	-4,644.40	-7,007.30
筹资活动所产生的现金流量净额	-3,737.01	9,106.85	9,256.07	-40.48
现金及现金等价物净增加额	-6,568.17	7,460.87	-3,565.57	-3,793.40

发行人销售商品、提供劳务收到的现金 2011 年比 2010 年增长 81.02%，2010 年比 2009 年增长 41.56%；发行人购买商品、接受劳务支付的现金 2011 年比 2010 年增长 49.02%，2010 年比 2009 年增长 64.30%。

报告期内，发行人经营性现金流量净额分析如下：

1、2009 年，发行人经营性活动产生的现金净流量为 3,254.06 万元，主要系当期第三四季度销售回升、销售货款回笼较好及应付账款增加所致。

2、2010 年，发行人经营性活动产生的现金净流量为-8,058.71 万元，明显低于当年实现的净利润水平，主要是受产能增加、销售规模扩大、原材料铜、黄金、白银价格上涨、应收票据增加等因素影响。具体原因主要如下：

(1) 2009 年下半年开始，发行人所处的半导体行业复苏，2010 年出现较大增长，发行人扩大产能、增加销售规模，同时，原材料不断涨价，导致 2010 年发行人存货有较大增加。2010 年底发行人存货比 2009 年底增加 1.11 亿元，增长率为 64.84%，2010 年底发行人存货周转率较上年下降，占用了部分经营性现金。

(2) 2010 年，随着业务规模扩大，发行人主营业务收入从 2009 年的 6.33 亿元增至 2010 年的 10.32 亿元，发行人下游客户的结算方式中应收票据的支付比例增加，导致发行人应收票据从 2009 年底不到 2,600 万元，增至 2010 年底的 1.41 亿元，应收票据增长 1.15 亿元，增长率达 443.33%，应收票据占总资产比例从 2009 年底的 2.39% 上升至 2010 年底的 9.92%。同时，2010 年底，发行人应收账款从 2009 年底的 2.29 亿元增至 2.45 亿元，较 2009 年增加 1,635.37 万元，增长 7.14%。

虽然 2010 年底，发行人应付票据和应付账款合计从 2009 年底的 1.27 亿元增至 1.81 亿元，增长 42.52%。但应收票据和应收账款的增长速度远高于应付票据和应付账款的速度，由于考虑到贴现率较高的财务费用因素，发行人在资金能够周转的情况下，尽量减少对应收票据的贴现，因此，较大地影响了 2010 年度的经营性现金流入。

综上所述，在发行人期末应收票据、应收账款和存货较大增长等因素的影响下，导致发行人 2010 年底的经营性现金流量净额低于当年实现的净利润水平。

3、2011 年，公司加强了存货、应收账款和应收票据管理，公司存货和应收账款周转天数分别由 2010 年的 92.78 天和 82.19 天下降到 2011 年的 72.73 天和 68.05 天，经营活动的现金流量有了一定的改善。同时，公司通过黄金租赁、国内信用证等方式，短期内减少了对公司经营性现金的占用。2011 年，发行人经营活动产生的现金流量净额明显高于当年实现的净利润水平，具体原因主要如下：

(1) 2010 年 10 月开始，公司部分原材料黄金的采购通过向银行租赁黄金的方式，在不占用公司货币资金的情况下，满足了生产对黄金原材料的需求。截止 2011 年底，未到租赁期的黄金租赁本金为 13,564.80 万元。发行人通过黄金租赁方式短期内减少了对经营性现金的占用。

(2) 2011 年公司在原材料采购中开始部分采用国内信用证方式，2011 年底，国内信用证余额为 4790 万元。短期内减轻了实际支付资金的压力。

(3) 2011 年，发行人业务规模进一步扩大，发行人加强了库存和应收账款管理，存货周转率和应收账款周转率分别为 4.95 和 5.29，较 2010 年存货周转率为 3.88 和应收账款周转率为 4.38 有了显著提高。2011 年末，发行人存货比 2009 年减少 1371.86 万元，减缓了存货成本对资金积压，在一定程度上改善了资金回流情况。

综上所述，由于发行人对黄金采购部分采用黄金租赁方式、对铜材及其他原材料采购部分采用国内信用证等方式，较大减少了发行人经营性现金流出。与此同时，在发行人与供应商票据结算的增加，以及发行人加强应收账款和存

货管理等因素的影响下，发行人 2011 年底的经营性现金流量净额明显高于当年实现的净利润水平。

4、发行人近三年投资活动产生的现金流量为资金净流出，2011 年发行人投资活动产生的现金流量较 2010 年增长 138.60%，主要系 2011 年购置土地、机器设备支出较上年增加所致。

5、发行人近三年筹资活动产生的现金流量主要为银行借款，2010 年筹资活动所产生的现金流量净额较 2009 年增加了 9,296.55 万元，主要系当期银行借款增加所致。

第四节 本次募集资金使用计划

一、本次募集资金使用计划

本次募集资金总额为9,276.00万元,扣除发行费用672.00万元后的募集资金净额为8,604.00万元,未超过本次募集资金投资项目拟使用的募集资金投资额59,950.00万元,本次募集资金拟投资以下项目:

序号	项目名称	总投资(万元)	募集资金拟投入(万元)	备案核准情况
1	年产3000万条高密度集成电路框架(QFN)生产线项目	31,100	31,100	甬发改审批[2011]773号
2	年产50亿只平面阵列式LED框架生产线(一期)项目	28,850	28,850	甬发改审批[2011]772号
	合计	59,950	59,950	-

鉴于本次非公开发行认购对象汇峰投资、任颂柳未能参与认购,本次募集资金净额低于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将按照上述项目所列顺序依次投入,不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,可以在募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目基本情况

(一) 年产3000万条高密度集成电路框架(QFN)生产线项目

1、项目基本情况

随着国内封装业的高速发展以及国外半导体封装企业向国内转移,国内引线框架需求量迅速增长。但引线框架的高端市场完全被国外企业控制,像高密度集成电路蚀刻QFN引线框架均需要进口。公司拟投资建设年产3000万条高密集成电路引线框架(QFN)生产线项目,项目建成投产后将实现进口替代。本项目总投资31,100万元,其中固定资产投资22,100万元,铺底流动资金9000万元。

本项目属于国家重点支持鼓励类项目。前期公司已承担了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的16个科技重大专项之一“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（以下简称“02专项”）中“成套封装设备与材料生产示范线工程”项目中第10个课题，在前期财政支持下，公司高密度集成电路蚀刻QFN引线框架已研发成功，具备了进行产业化的技术前提。

2、项目发展前景

随着电子产品向微型化、智能化和低功耗方向发展，为满足整机产品高密度组装要求，集成电路封装向高集成、高性能、多引线窄间距为特征的高密度方向发展。QFN封装产品正是顺应这一发展趋势下的产物，由于QFN封装产品卓越的散热和导电性能，以及体积小、节省空间的特点，自2003年问世以来，技术迅速走向成熟，广泛应用于消费类，特别是笔记本电脑、数码相机、掌上电脑（PDA）、移动电话和MP3等便携式电子产品。自2006年以来，QFN封装产品已成为便携式电子市场的主导趋势。

我国已成为全球电子整机产品的主要生产国和全球半导体第一大市场，中国集成电路市场需求预计到2013年将超过1001亿美元，占全球集成电路市场的三分之一以上，其中国内封装企业的引线框架需求量约占全球需求量的45%。尽管国内半导体行业每年以惊人的速度增长，但国产化率很低。内资企业的引线框架生产能力还远远不能满足其要求，处于供不应求的局面，尤其是高端封装用的蚀刻引线框架，几乎完全依赖进口。

近年来，长电科技、华天科技、通富微电等大型封装企业都加快、加大对QFN封装技术的投资，市场需求迅速增加，QFN引线框架产品迎来市场需求爆发的机遇。在02专项资金的前期引导下，康强电子对QFN框架产品的技术研发已经完成，技术储备成熟，在技术上和国内同行相比已经具有先发优势，本募投项目的早日建成投产，可促使公司尽快形成年产3000万条QFN框架产品的规模。该项目的投资，将及时迎合客户与市场需求，有助于提升公司在国际市场上的竞争力，缓解我国一直以来高端封装材料需要进口的被动局面。

3、项目经济评价

本项目建设完成达产后，预计年新增销售收入 60,000 万元，年新增利润总额 11,387 万元。

(二) 年产 50 亿只平面阵列式 LED 框架生产线（一期）项目

目

1、项目基本情况

LED 框架是生产 LED 照明的四大基本材料之一（芯片、框架、键合丝、灌封材料），LED 封装已从直插式（LED 指示灯）小功率向大功率和全彩方向迅猛发展，新一代平面阵列式封装是第三代封装形式，将成倍提高封装效率和降低成本，并改善 LED 散热和发光效率。因此，平面阵列式框架应运而生，并在短时间内获得迅速发展。由于大陆已成为全球最大的封装生产基地，框架生产也从日韩及台湾地区向大陆转移，目前国内生产正处于起步阶段。

本项目总投资 28,850 万元，其中固定资产投资 23,600 万元，铺底流动资金 5,250 万元。项目建成达产后将形成年产 50 亿只平面阵列型 LED 框架产品的产能，为 LED 显示、背光、照明用封装测试企业提供达到国际先进水平的框架。

本项目属国家“鼓励类二十四电子信息产业 24、电子专用材料制造”投资项目，也是“国家半导体照明工程”项目之一。

2、项目发展前景

与微电子相比，我国 LED 领域与国外的差距较小。我国自主研发的第一个发光二极管，比世界上第一个发光二极管仅仅晚几个月。总体上来看，目前我国半导体发光二极管产业的技术水平，与发达国家只相差 3 年左右。通过“863”计划等科技计划的支持，我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链，目前国内与 LED 产业相关的企业有 3000 多家，与 LED 封装相关的有 1000 多家，产品封装在国际市场上已占有相当大的份额。我国 LED 产业近年来发展迅速。LED 产品可广泛应用于景观照明、安全照明、特种照明和普通照明光源等领域，其市场潜力有上千亿元。

3、项目经济评价

本项目建设完成达产后，预计年新增销售收入 35,000.00 万元，年新增利润总额 8,572 万元。

三、本次募集资金的专户制度

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次发行保荐人光大证券股份有限公司认为：宁波康强电子股份有限公司本次非公开发行经过了必要的授权，并已取得中国证监会的核准；本次公开发行的定价、认购对象、发行数量等发行过程符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定；本次非公开发行发行对象的资格符合发行人 2011 年度第三次临时股东大会通过的本次发行方案的规定，符合上市公司及其全体股东的利益；对于本次发行后涉及的郑康定及其一致行动人豁免要约收购事项已履行相关程序，符合《上市公司收购管理办法》相关规定。发行人已依法实施本次发行，本次发行过程和发行对象均符合国家法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为：发行人本次非公开发行股票已经获得必要批准；本次非公开发行股票涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行股票所制作和签署的相关协议等文件合法有效；发行人本次非公开发行股票的过程公平、公正，符合中国法律的规定；发行人本次非公开发行股票所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行股票的股东大会决议和中国法律的规定。根据发行人出具的承诺，公司拟对未认购对象追究违约责任。本所律师认为，本次非公开发过程中，部分认购人未按照相关认购协议的约定履行认购义务不影响本次非公开发行股票的合法性。

第六节 新增股份数量及上市时间

本次非公开发行新增股份 1,200 万股，新增股份的相关股份登记托管手续已于 2013 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股份将于 2013 年 3 月 5 日在深圳证券交易所上市，公司股票价格在上市首日不除权。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为 36 个月，预计可上市流通时间为 2016 年 3 月 5 日(非交易日顺延)。

第七节 保荐协议主要内容及上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

光大证券与发行人于 2011 年 12 月 26 日签署了《宁波康强电子股份有限公司与光大证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。2013 年 2 月 1 日，双方又签署了《宁波康强电子股份有限公司与光大证券股份有限公司关于非公开发行股票保荐承销协议之补充协议》。保荐协议主要内容如下：

保荐人：光大证券股份有限公司

保荐代表人：竺勇、于荟楠

持续督导期限：本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

二、上市推荐意见

保荐人光大证券股份有限公司认为：康强电子申请其非公开发行股份上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人本次非公开发行股份具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券股份有限公司愿意推荐发行人的本次非公开发行股份上市交易，并承担相关保荐责任。

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京市康达律师事务所（公章）

律师事务所负责人：_____

付洋

经办律师：_____

鲍卉芳

王萌

苗丁

2013年2月27日

会计师事务所声明

本所及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要, 确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字的注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议, 确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师: _____
施其林

章磊

法定代表人: _____
胡少先

天健会计师事务所
2013年2月27日

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、光大证券股份有限公司关于宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书
- 2、光大证券股份有限公司关于宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告
- 3、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司非公开发行 A 股股票的法律意见
- 4、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司非公开发行 A 股股票的律师工作报告
- 5、中国证券监督管理委员会核准文件

二、查阅地点

1、宁波康强电子股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

电话：0574-56807119

传真：0574-56807088

2、光大证券股份有限公司

地址：上海市新闸路1508号

电话：021-22167133

传真：021-22167124

特此公告！

（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之盖章页）

宁波康强电子股份有限公司

2013年3月4日